

上海南芯半导体科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“南芯科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕365号文同意注册。《上海南芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（巨潮资讯网，<http://www.cninfo.com.cn>；中证网，<http://www.cs.com.cn>；中国证券网，<http://www.cnstock.com>；证券时报网，<http://www.stcn.com>；证券日报网，<http://www.zqrb.cn>）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	本次公开发行股票数量为 6,353.00 万股，占发行后总股本的比例为 15%。本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。
本次发行价格（元/股）	39.99
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	公司高级管理人员、核心员工通过中信建投证券股份有限公司设立中信建投股管家南芯科技科创板 1 号战略配售集合资产管理计划和中信建投股管家南芯科技科创板 2 号战略配售集合资产管理计划参与战略配售，最终获配数量 237.3422 万股。资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
保荐人相关子公司参	保荐人相关子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投

与战略配售情况	资”)参与本次发行战略配售,实际跟投比例为本次公开发行股票数量的3.00%,实际跟投股数为190.59万股。中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。		
发行前每股收益	0.66元(按2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)		
发行后每股收益	0.56元(按2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)		
发行市盈率	71.56倍(每股发行价格除以每股收益,每股收益按照2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算)		
发行市净率	4.99倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)		
发行前每股净资产	2.84元(按2022年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)		
发行后每股净资产	8.02元(按2022年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)		
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外);中国证监会或上交所等监管部门另有规定的,按其规定处理。		
承销方式	余额包销		
募集资金总额(万元)	254,056.47		
发行费用(不含税)	<p>本次发行费用明细为:</p> <p>1、保荐及承销费用:14,150.94万元;</p> <p>2、审计及验资费用:1,185.85万元;</p> <p>3、律师费用:698.11万元;</p> <p>4、用于本次发行的信息披露费用:457.55万元;</p> <p>5、发行手续费及其他费用:80.31万元。</p> <p>注:1、上述费用均为不含增值税金额;2、前次披露的招股意向书中,发行手续费及其他费用为24.60万元,差异原因系本次发行网上摇号取消了摇号费以及印花税的确定,除前述调整外,发行费用不存在其他调整情况。</p>		
发行人和保荐人(主承销商)			
发行人	上海南芯半导体科技股份有限公司		
联系人	梁映珍	联系电话	021-5018 2236
保荐人(主承销商)	中信建投证券股份有限公司		
联系人	股权资本市场部	联系电话	021-6882 2013 021-6880 1576

发行人：上海南芯半导体科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2023年3月30日

（本页无正文，为《上海南芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之签章页）

上海南芯半导体科技股份有限公司



2023年3月30日

（本页无正文，为《上海南芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司
2023年3月30日

